

## 本期封面



2000年2

栏目:

DOI:

论文题目: 碳化硅颗粒增强铝基复合材料(SiCp/2024Al)的扩散焊研究

作者姓名: 赵明久, 吕毓雄, 陈礼清, 毕敬

工作单位: 中国科学院金属研究所

通信作者: 赵明久

通信作者Email:

文章摘要: 采用加纯铝箔中间层的方法, 研究了15%SiCp/2024Al复合材料的固态扩散焊. 结果表明: 在温度为570°C、压力为16MPa、焊接时间为60min的条件下, 获得了较高质量的复合材料扩散焊接头. 对接头进行的剪切强度试验和金相分析发现, 焊接界面平行性特征不明显, 中间层明显变薄的接头具有较高的剪切强度. 扫描电镜观察分析显示, 接头断口呈现明显的韧性断裂特征.

关键词: 铝基复合材料, 碳化硅颗粒, 扩散焊接,

分类号:

关闭